

2026年5月15日

各 位

会 社 名 ニデックアドバンステクノロジー株式会社
代表者名 代表取締役社長 山崎 秀和
所 在 地 京都府向日市ニデックパーク 33 番地 C 棟

【新製品】半導体・プリント基板向け AI 検査・計測ソリューション 外観検査装置「AURCA（オルカ）」シリーズ販売開始について

ニデックアドバンステクノロジー株式会社（以下、当社）は、電子回路基板および半導体シリコンウエハ向け AI 検査・計測ソリューションである外観検査装置「AURCA（オルカ）」シリーズの販売を開始いたします。



AURCA 製品イメージ

■ 製品開発の背景

昨今 AI に牽引される電子デバイス市場の拡大とともに、微細化・複雑化が進む半導体製造プロセスには高度な信頼性が求められています。今般、当社は、従来の画像検査手法では検出困難だった欠陥への対応や歩留まりの向上など、製造現場の課題を解決するソリューションとして「AURCA」シリーズを開発いたしました。

■ 「AURCA（オルカ）」シリーズの特長

1. **高精度な欠陥検出（AI 画像処理）** 独自の AI アルゴリズムにより、従来の検査では識別が困難であった微細な欠陥や異常を高精度に検出します。
2. **フルカラー光学検査** 高度な光学設計によるフルカラー画像取得により、対象物の材質や高さの変化を正確に捉え、過検出を大幅に低減します。
3. **複数光源の画像をワンスキャンで同時処理** 検出したい欠陥に合わせて最適化された光源を複数使って同時にスキャン、あらゆる種類の欠陥を瞬時に検査します。

■ 「AURCA」シリーズが提供する価値

「AURCA」は、不良品の検出にとどまらず、AIによる高度な計測・解析データを通じて、製造現場の歩留まり改善に寄与します。

1. **欠陥の「真因」を分析** AI が検出した欠陥の形状や発生傾向を詳細に分析。単なる合否判定に留まらず、「なぜその欠陥が発生したのか」というメカニズムの解明をサポートします。
2. **製造工程へのダイレクトなフィードバック** 分析結果を前工程へ迅速にフィードバックすることで、製造工程の見直しや再発防止策の立案に役立てることが可能です。
3. **歩留まり向上の継続的なサイクルを実現** 「検査→分析→フィードバック→工程改善」というサイクルを回し続けることで、お客様の工場全体の歩留まりを最大化し、製造コストの低減と製品信頼性の向上に大きく貢献します。

【本件に関するお問い合わせ先】 ニデックアドバンステクノロジー株式会社

リリースに関するお問い合わせ：事業戦略グループ 075-280-8100

製品に関するお問い合わせ：営業部 075-280-8101